

レーザーサビ取り機

アブレーション技術を応用した
レーザー洗浄装置



メインモニタ



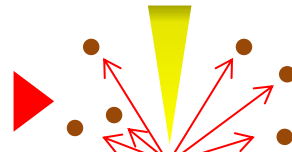
ヘッド部

加工イメージ

レーザー



サビ
母材



母材

金型のサビ取り



特徴

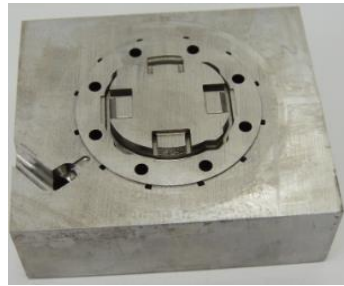
- 高ピーク・短パルスレーザー光による非接触加工
- ハンディータイプなので自在に加工できる。
- レーザーなので手の届かない箇所にも加工ができる。
- 薬剤を使わないサビ取りが可能のためコスト削減に期待できる。



PCL株式会社

Before

After



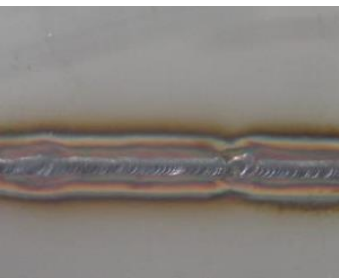
金型のサビ取り



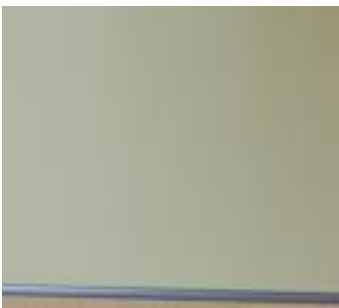
金型のサビ取り



ステンレスバケツのサビ取り



溶接焼けの除去



塗装の剥離

その他用途例

- ・モールドのガス焼けや付着物の除去
- ・溶接焼けなどの酸化被膜の除去
- ・塗装塗り替えなどによる塗装膜の剥離
- ・タービンブレードの付着物の除去

| 項目 | 仕様 | |
|------------|-----------------|--------------------------|
| 発振波長 | 1,064 nm | |
| 最大出力(CW発振) | 20 W | |
| 繰り返し周波数 | 30~80 kHz | |
| 焦点距離 | 330 mm | |
| 加工エリア | 205 mm × 205 mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.025 mm | |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| 電源圧 | 単相 AC100~240 V | |
| ブレーカー容量 | 最大50 A | |
| 重量 | 制御部 | 35 kg |
| | ヘッド | 5kg |
| 外形寸法 | 制御部 | 209(W) × 450(D) × 380(H) |
| | ヘッド | 97(W) × 97(D) × 145(H) |



PCL株式会社

〒613-0031 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷35-1

TEL:0774-45-2199 FAX:0774-45-1593

E-mail:kyoto@pcl-japan.com

URL:http://www.pcl-japan.com